

电子行业

2025年8月11日

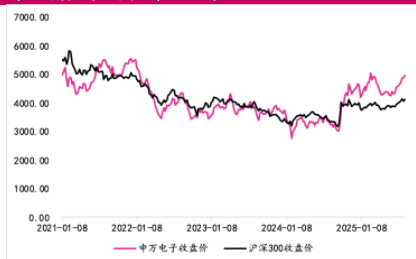
行业周度点评报告

—“China for China”战略已成为全球半导体产业的重要趋势

评级：增持（维持）

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
福日电子	15.31	43.62	90.79
硕贝德	27.25	42.08	125.57
阿石创	44.76	32.78	68.58
东芯股份	73.81	28.59	326.42
福日电子	15.31	43.62	90.79
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
南亚新材	45.04	-11.01	105.74
新亚电子	25.35	-10.61	82.21
兴森科技	16.53	-9.38	280.96
盛美上海	114.58	-7.63	505.63
恒玄科技	219.97	-7.34	370.36

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】周报 20250705 苹果首款折叠屏手机已进入原型试产阶段，聚焦折叠屏产业链投资机会

【金元电子】周报 20250712 AI与先进封装驱动 ABF 载板市场扩张，关注国产替代投资机会

【金元电子】周报 20250719 台积电 Q3 指引超预期、AI 与先进制程成增长双引擎

【金元电子】周报 20250725 世界人工智能大会，昇腾 384 超节点引领 AI 算力新纪元

【金元电子】周报 20250804 中美芯片博弈再升级，关注 H20 安全审查背后的国产替代机遇

分析师：王昭杰

执业证书编号：S0370525030002

电话：0755-21515595

邮箱：wangzj@jyzq.cn

- **全行业：**本周（2025.08.04-2025.08.08）上证指数上涨2.11%，深证成指上涨1.25%，沪深300指数上涨1.23%，申万电子板块上涨1.65%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为21/31。板块个股涨幅前五名分别为：福日电子、硕贝德、阿石创、东芯股份、福日电子；跌幅前五名分别为：南亚新材、新亚电子、兴森科技、盛美上海、恒玄科技。
- **电子行业：**本周（2025.08.04-2025.08.08）国内电子行业整体涨幅明显分化。消费电子板块涨幅居前，达4.27%，主要受品牌消费电子大幅上涨6.81%拉动，消费电子零部件及组装也上涨3.92%，表现强劲。其他电子板块上涨4.06%，三级行业走势一致。电子化学品板块上涨2.70%，电子化学品III类涨幅相同。半导体板块整体上涨1.45%，分立器件和半导体材料表现相对较强，分别上涨4.40%和2.91%；元件板块整体下跌1.59%，印制电路板下跌2.59%，而被动元件则逆势上涨2.67%。总体来看，电子行业本周由消费电子和其他电子板块领涨，光学元件及部分半导体子行业（如分立器件）亦有亮眼表现。
- **行业要闻**
 - ◆ OpenAI 启动挪威资料中心建设
 - ◆ 软银集团正在增持英伟达和台积电股份
 - ◆ 华为宣布 CANN 全面开源开放，共建昇腾生态
 - ◆ 台积电2纳米技术疑遭泄密，3名工程师遭羁押禁见
 - ◆ 2025年上半年全球电视出货排名出炉，TCL位居第二
- **公司动态：**
 - ◆ 德邦科技：持股5%以上股东减持股份计划公告
 - ◆ 电连技术：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
 - ◆ 华勤技术：向2025年限制性股票激励对象授予预留部分的公告
 - ◆ 燕东微：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
 - ◆ 工业富联：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
- **投资建议：**我们认为，在当前半导体供应链本土化加速的背景下，投资者需要把握三条主线：一是聚焦中芯国际在成熟制程和特色工艺领域的持续增长机会；二是关注国产半导体设备及材料企业的配套发展机遇；三是留意国内芯片设计公司供应链本土化带来的产业链协同效应。
- **风险提示：**行业周期性波动风险、地缘政治及政策风险、市场竞争加剧风险、供应链本土化推进不及预期风险

目 录

一、核心观点.....3

二、行业跟踪.....5

三、行业新闻.....7

四、公司公告.....13

五、下周投资提示.....16

图表目录

图 1：本周各行业版块涨跌幅.....5

图 2：本周电子版块：子版块涨跌幅6

图 3：电子板块历史走势7

图 4：电子板块历史市盈率.....7

表 1：中芯国际近 6 个季度营收.....3

表 2：中芯国际近 6 个季度销售.....4

表 3：本周电子板块个股涨幅前五名5

表 4：本周电子版块个股跌幅前五名5

表 5：下周重要会议.....16

表 6：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）17

一、核心观点

中芯国际二季报揭示了半导体国产化进程中“规模与盈利”的平衡难题。中芯国际连续四个季度营收突破 20 亿美元大关，其中工业与汽车芯片收入环比增长 8.5%，8 英寸晶圆收入环比增长 6.6%，这两大业务板块有效抵消了消费电子领域的需求疲软。然而，毛利率为 20.4%，环比下滑 2.1 个百分点，但仍高于公司指引的 18%至 20%区间。净利润为 1.32 亿美元，同比下滑 19.5%，主要受到研发开支环比大幅增加 22.2%以及新产线开办费用上升的影响。虽然毛利率较去年同期的 13.9%提升了 6.5 个百分点，但折旧成本同比增加 10.2%至 8.79 亿美元，叠加产品平均售价环比下降 5.7%，这些因素共同压制了短期利润表现。公司对三季度的指引也较为保守，预计收入仅环比增长 5%-7%，毛利率维持在 18%-20%，低于市场预期。综合来看，市场对其“增收不增利”的表现及未来预期感到担忧，中芯国际 2025Q2 财报发布后股价大幅下跌 A 股跌 4.34%、港股跌 8.19%。

表 1：中芯国际近 6 个季度营收

数据类别	2024 年 Q1	2024 年 Q2	2024 年 Q3	2024 年 Q4	2025 年 Q1	2025 年 Q2
营业收入（亿美元）	17.50	19.01	21.70	22.07	22.47	22.09
营业收入同比	19.70%	21.80%	33.90%	31.50%	28.40%	16.20%
营业收入环比	4.30%	8.60%	14.20%	1.70%	1.80%	-1.70%
归母净利润（亿美元）	0.72	1.65	1.49	1.08	1.88	1.32
归母净利润同比	-68.90%	-59.10%	58.3%	-38.40%	161.9%	-19.50%
归母净利润环比	-58.90%	129.20%	-9.60%	-27.70%	74.80%	-29.50%
毛利率	13.70%	13.90%	20.50%	22.60%	22.50%	20.40%
产能利用率	80.80%	85.20%	90.40%	85.50%	89.60%	92.50%

数据来源：Choice、公司季度报告、金元证券研究所

2025Q2 中芯国际产能利用率进一步提升至 92.5%，环比增长 2.9 个百分点，接近满产状态，凸显半导体行业需求的强劲韧性。公司月产能由 Q1 的 97 万片（折合 8 英寸）扩大至约 99 万片，当季实际销售晶圆达 239.02 万片，出货量环比增长 4.3%，同比增长 13.2%。从业务平台来看，模拟芯片需求增长尤为显著，这主要得益于手机快充、电源管理等领域的国产化替代加速推进。凭借与国内客户的深度合作及定制化工艺平台优势，公司成功抓住这一市场机遇，获得大量增量订单。此外，图像传感器平台收入环比增长超过 20%，射频业务也实现较高增幅，多元化的产品布局为公司业绩提供了有力支撑。

表 2：中芯国际近 6 个季度销售

类别		2024 年 Q1	2024 年 Q2	2024 年 Q3	2024 年 Q4	2025 年 Q1	2025 年 Q2
地区销售收入占比	中国区	81.6%	80.30%	86.4%	89.1%	84.30%	84.10%
	美国区	14.9%	16.0%	10.6%	8.9%	12.60%	12.90%
	欧亚区	3.5%	3.7%	3.0%	2.0%	3.10%	3.00%
	其他						
终端应用销售收入	智能手机	31.2%	32.0%	24.9%	24.2%	24.20%	25.20%
	计算机与平板	17.5%	13.3%	16.4%	19.1%	17.30%	15.00%
	消费电子	30.9%	35.6%	42.6%	40.2%	40.60%	41.00%
	其他	20.4%	19.1%	16.1%	16.5%	17.90%	18.80%
按尺寸分类	8 英寸晶圆	24.4%	26.4%	21.5%	19.4%	21.90%	23.90%
销售收入占比	12 英寸晶圆	75.6%	73.6%	78.5%	80.6%	78.10%	76.10%
实际出货量（万片）	8 英寸晶圆约当量	179	211.19	212	199.18	229	239.02
月产能变化（万片）	8 英寸晶圆约当量	81.45	83.7	88.43	94.76	97.32	99.13
资本开支（亿美元）	资本开支	22.35	22.52	11.79	16.6	14.15	18.85

数据来源：Choice、公司季度报告、金元证券研究所

“China for China” 战略已成为全球半导体产业的重要趋势，这一供应链策略强调“在中国制造、服务中国市场”。在美国对中国半导体和芯片实施严格限制的背景下，包括意法半导体、英飞凌、恩智浦等国际 IDM 大厂纷纷调整战略布局，以维护其在中国市场的业务。意法半导体已宣布将 40nm MCU 产品线交由华虹集团代工；恩智浦着手建立本土供应链体系；英飞凌则积极推进产品生产本土化进程，将部分产品转由中国晶圆代工厂生产。GlobalFoundries 在最新财报中披露，已与中国本土代工厂达成战略合作，为其中国大陆客户提供基于汽车级工艺技术的可靠供应。这一战略转型不仅重构了中国半导体供应链生态，更为全球晶圆代工行业开辟了新的增长空间。

投资建议：

我们认为，在当前半导体供应链本土化加速的背景下，投资者需要把握三条主线：一是聚焦中芯国际在成熟制程和特色工艺领域的持续增长机会；二是关注国产半导体设备及材料企业的配套发展机遇；三是留意国内芯片设计公司供应链本土化带来的产业链协同效应。

风险提示：

1、行业周期性波动风险

半导体行业具有强周期性，若全球需求放缓或产能过剩，可能导致价格竞争加剧，企业营收及利润承压。

2、地缘政治及政策风险

国际供应链环境复杂，若海外技术封锁或出口管制进一步升级，可能对国内半导体产业链的产能扩张和技术突破形成制约。

3、市场竞争加剧风险

随着本土化进程加速，国内外企业可能加大投入，行业竞争或趋于激烈，部分

企业可能面临价格战或利润率下滑的风险。

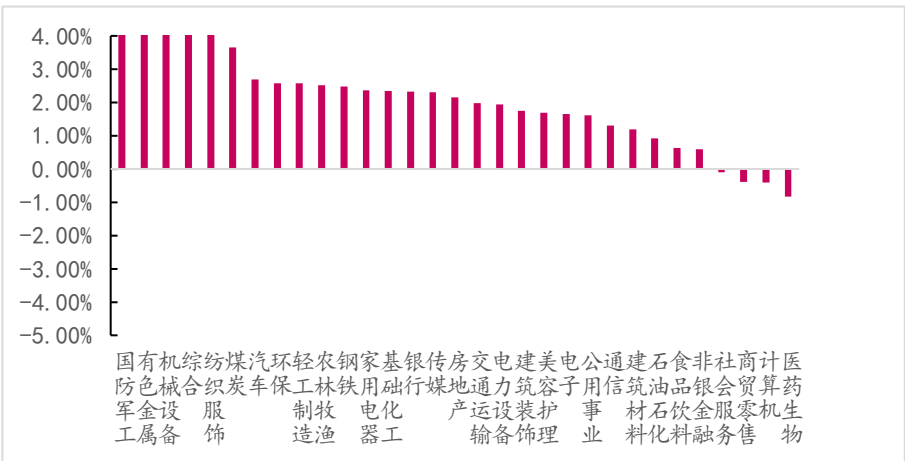
4、供应链本土化推进不及预期风险

若国内设备、材料等关键环节的国产替代进度缓慢，可能制约芯片制造及设计企业的产能释放和成本优化。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025. 08. 04-2025. 08. 08）上证指数上涨 2. 11%，深证成指上涨 1. 25%，沪深 300 指数上涨 1. 23%，申万电子板块上涨 1. 65%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 21/31。板块个股涨幅前五名分别为：福日电子、硕贝德、阿石创、东芯股份、福日电子；跌幅前五名分别为：南亚新材、新亚电子、兴森科技、盛美上海、恒玄科技。

图 1：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 3：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
600203.SH	福日电子	43.62	15.31	10.47	16.28	143.41	850.41	118.27
300322.SZ	硕贝德	42.08	27.25	18.80	28.20	150.78	665.25	153.29
300706.SZ	阿石创	32.78	44.76	33.03	51.51	164.11	186.38	76.70
688110.SH	东芯股份	28.59	73.81	60.00	73.81	75.71	334.84	220.47
002289.SZ	ST 宇顺	27.65	25.99	20.62	25.99	9.12	25.54	5.85

数据来源：Choice，金元证券研究所

表 4：本周电子板块个股跌幅前五名

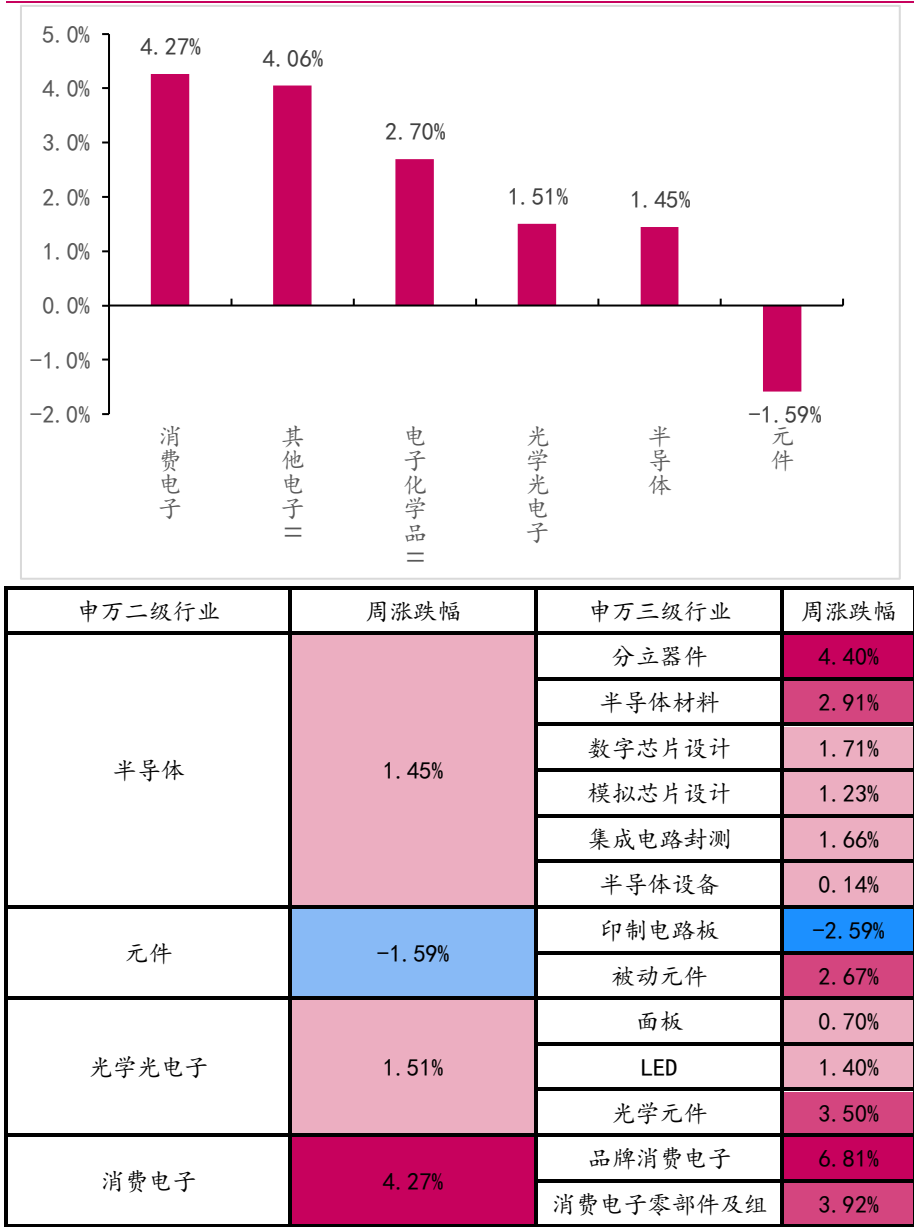
证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688519.SH	南亚新材	-11.01	45.04	44.85	50.39	9.43	21.77	10.26
605277.SH	新亚电子	-10.61	25.35	25.01	29.26	47.90	150.41	40.43
002436.SZ	兴森科技	-9.38	16.53	16.20	17.99	39.38	594.84	101.29

688082.SH	盛美上海	-7.63	114.58	114.28	125.58	2.85	12.44	14.91
688608.SH	恒玄科技	-7.34	219.97	218.28	237.18	11.03	18.57	42.29

数据来源: Choice, 金元证券研究所

电子行业: 本周(2025.08.04-2025.08.08)国内电子行业整体涨幅明显分化。消费电子板块涨幅居前,达4.27%,主要受品牌消费电子大幅上涨6.81%拉动,消费电子零部件及组装也上涨3.92%,表现强劲。其他电子板块上涨4.06%,三级行业走势一致。电子化学品板块上涨2.70%,电子化学品III类涨幅相同。半导体板块整体上涨1.45%,分立器件和半导体材料表现相对较强,分别上涨4.40%和2.91%;元件板块整体下跌1.59%,印制电路板下跌2.59%,而被动元件则逆势上涨2.67%。总体来看,电子行业本周由消费电子和其他电子板块领涨,光学元件及部分半导体子行业(如分立器件)亦有亮眼表现。

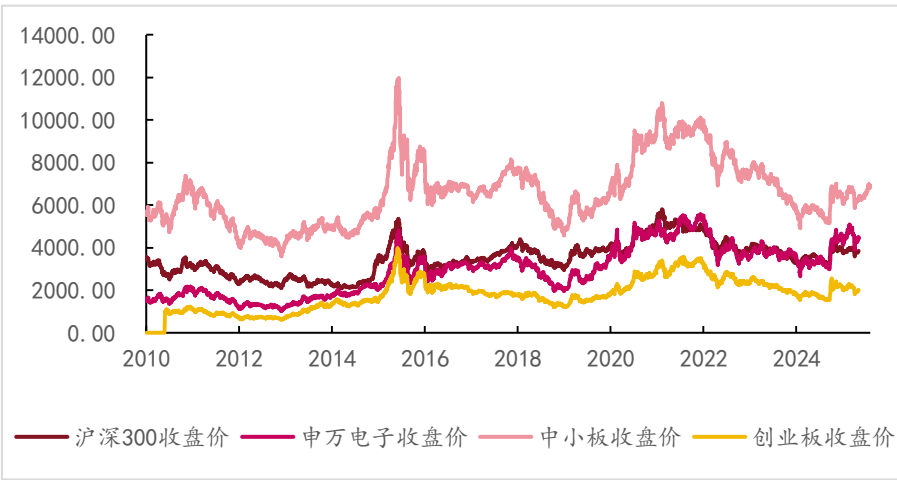
图 2: 本周电子版块: 子版块涨跌幅



		装	
电子化学品	2.70%	电子化学品 III	2.70%
其他电子	4.06%	其他电子 III	4.06%

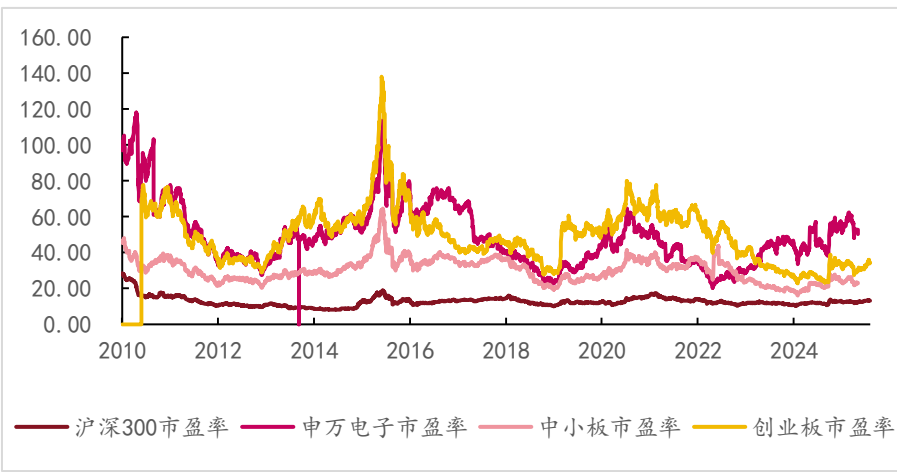
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 3: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 4: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

SK海力士首次超越三星，成为全球最大记忆体制造商

8月4日科技新报消息，受人工智能AI需求的推动，SK 海力士在 2025 年第一季度首次超越三星电子，成为全球最大的记忆体制造商。三星电子7月31日发布的财报显示，截至6月的三个月内，其记忆体营收降至 21.2万亿韩元。而 SK 海力士一周前公布的第一季度营收为 21.8万亿韩元，这表明两者之间的差距正在扩大。这一里程碑标志着 DRAM 市场领导地位自1992年以来首次发

生变化。SK 海力士在高带宽记忆体市场的强势地位是其成功的关键，这对于人工智能和高性能计算工作负载至关重要。SK 海力士拥有超过70% 的市场份额，并且是英伟达等主要人工智能芯片制造商的主要供应商。先进记忆体解决方案的需求正在激增，SK海力士在HBM3和HBM3E领域的积极投资和创新使其脱颖而出。今年，SK海力士的DRAM营收预计将达到496亿美元，超过三星的464亿美元。HBM在SK海力士营收中的占比正在不断提升，从2019年的3%上升到2025年的42%。此次领导层的更迭凸显了人工智能记忆体创新和战略合作正在重塑全球半导体记忆体市场。

台积电启动SoW-X先进封装研发，用于生产高性能数据中心AI芯片

8月4日科技新报消息，从智能手机、可穿戴设备、移动游戏机到台式电脑、服务器和大型数据中心设备，处理器的应用范围极其广泛，芯片尺寸也多种多样。目前高端个人电脑中的处理器，例如AMD 的 Ryzen 9 9950X3D 和英特尔的 Core Ultra 9 285K，都采用多个小芯片技术，将多个芯片集成封装成一个更大的处理器。传统的芯片封装技术通常在约 7,000 平方毫米的基板上安装三到四个小芯片。然而，SoW-X 芯片封装技术将使芯片尺寸增加 10 到 15 倍，甚至需要使用整块 12 英寸晶圆。最显著的进步之一是在同一晶圆上集成更多关键组件。台积电第一代 SoW 封装仅将处理芯片安装在晶圆上，而全新的 SoW-X 版本则可直接集成高带宽记忆体芯片。这种突破性的集成技术无需昂贵且复杂的外部互连来连接内存和处理器，从而显著简化了系统设计并提高了效率。

OpenAI启动挪威资料中心建设

8月4日科技新报消息，星际之门是OpenAI的基础设施平台，是实现“让AI的好处普及至每个人”这个长期愿景的关键一环。OpenAI 31日宣布启动挪威星际之门“Stargate Norway”，这是“OpenAI for Countries”计划在欧洲展开的第一项AI资料中心专案，落脚挪威北部的那维克。Stargate Norway预计提供230 MW用电规模的算力，并计划日后扩充290 MW。这项设施目标在2026年底部署10 万颗NVIDIA GPU，未来数年继续扩增。Stargate Norway的合作伙伴包含Nscale、Aker两家公司，前者在欧美云端基础设施建设上是经验丰富的 AI 基础设施供应商，后者在能源和工业领域拥有百年历史。Stargate Norway由Nscale设计和建造，OpenAI则是首批采购算力的公司之一。Stargate Norway优先开放给挪威 AI 生态系使用，确保当地新创公司和研究机构能取得算力。

三星暗示HBM3E将走跌，疑为抢NVIDIA订单先铺路

8月4日电电子时报消息，三星电子相关人士稍早暗示，第五代高带宽记忆体HBM 3E，由于供应量超过市场需求，价格可能走跌。南韩业界认为，三星此番谈话似乎暗示，市场供需将出现变化，为了早日向NVIDIA供货，三星很可能提出，包括降价在内的多项方案。综合ZDNet Korea、韩国经济等消息，日前三星举行2025年第2季财报电话会议，会中相关人士表示，由于HBM3E供应超过需求，市场供需关系将发生变化，短期内也将影响价格。HBM3E是目前已商用化的最新一代HBM，根据堆叠层数分为8层及12层。随着NVIDIA、超微等全球大型科技企业，纷纷推出最新人工智能加速器，2025年12月HBM3E需求成长显著。三星

HBM3E的竞争对手SK海力士及美光，正积极量产12层HBM3E。南韩业界认为，三星HBM3E营销策略，将为市况带来重大影响。

Rapidus资深工程师传承危机，人才是今后重要挑战

8月4日电子时报消息，Rapidus继4月工厂启动后，7月确认了2纳米半导体试作品的运作，目前正朝提升芯片效能与生产良率的方向前进。此时，Rapidus生产技术部、技术战略室的负责人都认为，人才是重要挑战。日经新闻报导，Rapidus生产技术部长高桥久透露，公司2024年12月25日引进极紫外光曝光机，在此前后每天与EUV曝光机制造商荷兰ASML的技术人员召开会议，详细检查进度。通常EUV曝光机安装完成需半年，Rapidus却反复强调2025年4月1日必须完成，ASML方面都半信半疑，最后还是在4个月内完成安装并启动。设备团队中有约30名经验丰富的资深工程师，均曾在NEC、日立制作所、三菱电机、东芝等公司参与工厂兴建。虽然日本的芯片开发能力尚不足，但高桥久强调，将研发成果落实到量产，日本在这方面具全球第一的实力，经验丰富的资深员工，正将这些宝贵的技术和知识传承给年轻一代。

吨级无人飞行器首次完成海上平台物资运输，低空经济迎发展新机遇

8月4日智通财经网消息，我国自主研发的吨级以上电动垂直起降航空器，首次实现远海石油平台物资运输飞行。这一突破，标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。业内人士指出，近年来，伴随技术的不断进步、标准体系的加速完善、应用场景的日益拓展，低空经济作为战略性新兴产业，正迎来前所未有的发展机遇。中国海油深圳分公司协调部副经理任永怡表示，相比传统依赖船舶和直升机的运输方式，电动垂直起降航空器在运营成本、响应速度、环保零碳、舒适性以及适应有限起降空间方面具有显著优势。政策支持上，低空经济领域政策密集出台，深圳再出重磅方案，着眼于低空基建，起降点建设是本次规划的重点之一。

软银集团正在增持英伟达和台积电股份

8月5日观点网消息，8月5日，软银集团正在增持英伟达和台积电股份，彰显孙正义对人工智能工具与硬件的高度关注。监管文件显示，截至3月底，软银在英伟达持仓规模从10亿美元增至约30亿美元；同时购入约3.3亿美元台积电股票和1.7亿美元甲骨文股票。该行动突显软银加速AI领域投资布局的重要性。据知情人士透露，软银旗下愿景基金在2025年上半年变现近20亿美元资产，以投资回报为首要目标。Arm在软银AI战略中居核心地位，孙正义正与行业巨头合作构建投资组合，追赶此前错过的英伟达和台积电市值飙升行情。

前AMD、英特尔显卡架构师Raja再战GPU，号称要从原子到智能体全面重构

8月5日IT之家消息，知名GPU架构师拉贾·科杜里(Raja Koduri)此前曾先后在AMD和英特尔的显卡部门担任要职。而在今日，由Raja创立的GPU软件与IP初创企业Oxmiq Labs在两年的蛰伏后正式公开亮相。Oxmiq Labs宣称将从原子到智能体的全部层次重构GPU堆栈。其以优先IP授权而非实体芯片制造的形式开展业务，IP组合包含RISC-V内核微智能体、近存/存内计算、光传输等一系列关键技术，为客户提供兼具灵活性与性能的GPU解决方案。

华为宣布 CANN 全面开源开放，共建昇腾生态

8月5日IT之家消息，今天，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自 AI 领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态，加速 AI 创新和发展。华为轮值董事长徐直军在主题演讲中强调：华为 AI 战略的核心是算力，并坚持昇腾硬件变现。徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能 CANN 全面开源开放，Mind 系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。与会代表和华为共同发起了《CANN 开源开放生态共建倡议》，以凝聚产业力量，共探 AI 边界，共建昇腾生态。

Cloudflare 称 Perplexity 绕过限制，抓取明令禁止 AI 抓取的网站

8月5日IT之家消息，当地时间周一，Cloudflare发布了一份报告，指控AI初创公司Perplexity在网站已明确标注禁止AI抓取的情况下仍进行抓取，并通过改变身份标识规避拦截规则。报告显示，Perplexity忽略网站robots.txt文件及针对其已知爬虫的拦截规则，调整UA和ASN信息，通过更换身份和网络地址等手段绕过屏蔽并抓取大量内容。Cloudflare称，他们通过“机器学习与网络信号相结合”的方式，识别出了Perplexity爬虫的特征，其行为涉及“数万个域名，每天数百万次请求”。针对指控，Perplexity发言人Jesse Dwyer表示：Cloudflare的博文是“销售噱头”，并表示文中截图“显示没有内容被访问”。在后续邮件中，Dwyer进一步否认，称Cloudflare提到的机器人“甚至不是我们的”。

英伟达桌面CPU出师不利，生态与量产难题成最大掣肘

8月5日三言科技消息，英伟达首款桌面CPU GB10遭遇“难产”，原计划7月上市的DGX Spark至今未见踪影。该产品采用与联发科共同开发的GB10芯片，基于Arm架构，算力约1000 TOPS (FP4)，配备128GB LPDDR5X内存，总带宽273GB/s，旨在满足AI模型推理需求。然而，高集成度的系统级封装技术导致量产良品率偏低，生产流程复杂，如台积电的CoWoS-L封装工序需精确控制温差。此外，定价过高，基础版售价约3.3万元人民币，高配版超4万元，普通开发者难以承受。软件生态方面，Arm架构应用稀缺，32位应用转译后性能损失严重，64位软件和游戏转译后常卡死，影响使用体验。英伟达在CPU领域的生态构建面临巨大挑战，需与OEM厂商和微软等合作伙伴紧密合作，共同推动关键应用的原生Arm版本落地，优化转译层效率，以克服生态难题。

SK海力士打算提高HBM4定价，幅度达70%，利用提前交货优势提高溢价

8月5日新浪财经消息，在台积电（TSMC）今年的2025年北美技术论坛上，SK海力士首次公开展示了HBM4技术。HBM4属于第六代HBM产品，将在下一代AI硬件中发挥至关重要的作用。SK海力士的首个客户的英伟达，后者计划将HBM4用于下一代数据中心使用的Rubin GPU。据Wccftech报道，SK海力士是最早生产HBM4的存储器制造商，为AI芯片提供了现成的解决方案。凭借与英伟达供应链的独家合作关系，加上更高的成本，SK海力士打算提高HBM4的定价，相比HBM3E可能高出70%。

台积电2纳米技术疑遭泄密，3名工程师遭羁押禁见

8月6日国际电子商情消息，台积电近期爆出2纳米制程技术机密外泄案，台湾检方已对涉案的3名工程师申请羁押禁见并获法院批准。事件起因于公司内部侦测系统发现异常网络行为，涉案员工涉嫌在远程办公期间短时间内反复访问2纳米核心资料，外泄文件多达400余张，内容涉及试产参数与研发细节，最终流向日系设备公司一名前员工。该事件发生在2纳米量产前夕，恐对台积电全球技术领先地位造成重大冲击，台积电已启动法律程序并声明将严惩泄密行为。

半导体巨头抢滩具身机器人赛道，2025年进入量产元年

8月6日国际电子商情消息，具身机器人赛道在政策扶持和头部企业推动下进入加速发展阶段，被视为“AI+机器人”融合的核心方向。2025年不仅是相关技术多项突破的一年，也被认为是具身机器人正式步入量产“元年”。安森美、ADI、瑞萨、兆易创新、艾迈斯欧司朗等半导体巨头纷纷布局关键组件与系统解决方案，推动机器人在工业制造、物流仓储、家庭服务等场景落地。尽管高精度感知、低功耗设计、灵巧手等关键技术仍存挑战，但全球市场规模已被IDC预测将在2029年突破4000亿美元，具身机器人正从实验室迈向现实社会的各个角落。

2025年上半年全球电视出货排名出炉，TCL位居第二

8月6日集邦Display消息，TrendForce集邦咨询发布2025年上半年全球电视出货数据，整体出货达9,250万台，年增2%。TCL凭借政策红利与国际环境变化出货年增12.5%，超越LG升至全球第二，仅次于三星，海信、小米分列第三、第五。Vizio因沃尔玛渠道优势出货增长13%，增幅居各品牌之首。同期，Mini LED电视全球出货年增达67%，中国品牌市占率升至62%，成为技术升级核心驱动力。尽管全年出货预估略降至1.957亿台，但各品牌正通过高端技术布局争夺结构性增长机会。

上海发布具身智能产业发展方案，目标2027年核心产业规模破500亿元

8月6日中国电子报消息，上海市人民政府办公厅近日印发《具身智能产业发展实施方案》，明确提出到2027年将实现不少于20项核心技术突破，推动百家骨干企业集聚、百大应用场景落地，力争具身智能核心产业规模突破500亿元。方案从模型创新、公共平台建设、应用示范、产业链协同及生态塑造等五大方面系统推进，重点聚焦感知决策、运动控制、语料数据等关键技术，力图将上海打造为全球具身智能产业创新高地。

陆家嘴沙龙聚焦集成电路新生态，技术整合与资本并进驱动行业重塑

8月6日财联社消息，第22期陆家嘴金融沙龙日前在上海浦东举行，围绕“集成电路产业发展的机遇与挑战”主题，来自张江高科、集成电路产业基金、概伦电子、沐曦芯片等企业的高管共议技术整合、资本赋能与生态重构。与会嘉宾强调，RISC-V、硅光、EDA、汽车芯片等前沿方向将成未来“核爆点”，并购整合和生态协同是产业提速关键。与此同时，AI芯片被视为推动产业升级的核心引擎，国产GPU、大模型算力平台的适配正成为新焦点。产业各方呼吁以耐心资本与战略国资推动技术迭代，构建集成电路的“中国方案”。

格芯与中国晶圆厂达成协议，强化本地供应链布局

8月6日全球半导体观察消息，晶圆代工巨头格芯公布2025年第二季度营收达16.88亿美元，同比增长3%。在财报中，格芯宣布已与一家中国本土晶圆厂达成最终合作协议，将为其在华客户提供汽车级CMOS等关键芯片的本地化代工服务。此次合作标志着格芯“以中国为中心”战略迈出关键一步，有助于增强中国市场的供应链韧性，降低客户工艺迁移成本，并推动本土半导体产业链升级和国产替代进程。

三星显示以6000尼特刷新MicroLED智能手表屏幕亮度记录，较年初提升50%

8月7日IT之家消息，K-Display2025韩国显示产业展正在首尔进行，作为韩国两大光电显示企业之一的三星显示带来了全球最亮MicroLED技术智能手表显示面板。三星显示在今年初的CES2025上曾展出过4000nits亮度的MicroLED智能手表屏幕。而在约七个月之后，三星显示通过发光效率的提升将这一数值提升50%到6000尼特。该显示产品分辨率为326PPI，内含约70万个超小型三色LED芯片。而在OLED技术方面，三星带来了1.3英寸4000PPI像素密度1000nits亮度W-OLED双目显示、1.4英寸5000PPI像素密度RGBOLED、采用MLA技术的1.3英寸4200PPI像素密度20000nits亮度RGBOLED等尖端微显示器产品。

首次展示世界最快OLED显示器面板为27英寸QHD规格且具备540Hz刷新率

8月7日IT之家消息，LGDisplay宣布将以“塑造未来”为主题在今日开幕的K-Display2025韩国显示产业展上展示覆盖大/中/小尺寸的全面显示技术与产品。在本次展会中，LGDisplay将首度公开展示全球最快的OLED显示器面板。这款27英寸的第四代WOLED面板对角线长27英寸，标准模式下为2560×1440540Hz，使用DFR技术可切换为1280×720720Hz的低分超高刷模式；该面板还具有99.5%DCI-P3色域覆盖和1500nits峰值亮度。LGDisplay还展出了一款面向车内拨盘应用的可伸缩MicroLED显示产品，拉伸幅度可达53%。

爱速特推出AS72R旗舰机架式12/16盘位NAS，搭载八核AMD“Zen4”处理器

8月7日IT之家消息，ASUSTOR华芸/爱速特今日正式宣布推出AS72R系列12/16盘位旗舰级机架式NAS，分别是型号AS7212RDX的Lockerstor12RPROGen2和型号AS7216RDX的Lockerstor16RPROGen2。这两款机架式NAS均搭载性能强劲的AMD锐龙7PRO7745，这颗8核心“Zen4”微架构5.3GHz处理器支撑AS72R系列满足中大型企业对高性能存储与虚拟化应用的需求。

联电 7 月营收 200.4 亿元，月增 6.5% 创 2025 年次高纪录

8月8日科技新报消息，晶圆代工大厂联电6日公布2025年7月份营收，营收金额为新台币200.4亿元，为2025年单月次高纪录，较6月份增加6.5%、较2024年同期则是减少4.1%。累计，2025年前七个月营收为1,366.57亿元，较2024年同期增加3.3%。联电在日前法说会上表示，2025年第二季合并营收达新台币587.6亿元，与前一季的578.6亿元相比，营收成长了1.6%。与2025年同期相比，成长3.4%，显示持续扩张动能。而展望第三季，联电对晶圆出货量的预期仍是略有增加。然而，公司也预警指出，不利的汇率变动将导致以新台币计算的营收减少。这再次突显外汇波动对公司财务表现的潜在影响。而面对总体经济与地缘政治的复杂挑战，联电将密切关注市场短期内的不确定

定性与风险，特别是美国关税政策的持续受到关注。

苹果公司宣布 6000 亿美元美国制造计划，以免遭受惩罚性关税

8 月 8 日电子工程专辑消息，苹果公司表示，将把在美国制造业的投资增加至 6000 亿美元，以推进“美国制造计划”。苹果公司此前曾承诺在未来四年内在美国投入 5000 亿美元，此次再追加 1000 亿美元，使总投资额达到 6000 亿美元。这一投资计划被视为苹果公司对特朗普政府“美国优先”经济议程的响应。苹果公司推出的“美国制造计划”，旨在深化与美国本土企业的合作，推动美国制造业的发展。该计划包括与康宁、德州仪器、应用材料、三星、格芯、安靠、博通等公司合作，扩大美国制造业的布局。

四、公司公告

燕东微:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

公司8月4日发布公告，根据 2025 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，北京燕东微电子股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 22 5,083,986 股，发行价格为每股人民币 17.86 元，募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，未超过募集资金规模上限，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 14,922,641.50 元后，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，上述资金已全部到位。

工业富联:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

公司8月4日发布公告，经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位。

芯海科技:关于向激励对象授予2024年股权激励部分限制性股票的公告

公司8月4日发布公告，芯海科技（深圳）股份有限公司规定的公司 2024 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 8 月 1 日为预留授予日，并同意向 8 名激励对象以 37.00 元/股授予 70.00 万股限制性股票。

华勤技术:向2025年限制性股票激励对象授予预留部分的公告

公司8月4日发布公告，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的预留授予日为 2025 年

8 月 4 日，同意以 39.96 元/股的授予价格向 91 名激励对象授予 46.43 50 万股限制性股票。

清溢光电：开立募集资金现金管理专用结算账户并签署四方监管协议的公告

公司8月5日发布公告，深圳清溢光电股份有限公司于2025年5月16日召开第十届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。

芯朋微：股东减持股份计划的公告

公司8月5日发布公告，截至本公告披露日，无锡芯朋微电子股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员张立新先生持有公司股份34,301,000股，占公司总股本的26.12%，均为首次公开发行A股股票前获得的股份。张立新先生因个人资金需求，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，拟通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持股份不超过2,626,206股，减持比例不超过公司总股本的2%。

联动科技：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

公司8月5日发布公告，公司于2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年年度利润分配方案为：“以公司现有总股本剔除已回购股份622,947股后的69,855,821股为基数，向全体股东每10股派2.60元人民币现金，合计派发现金股利人民币18,162,513.46元，不送红股，不进行资本公积金转增股本”。该利润分配方案已于2025年5月27日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股。

雅创电子：2024年年度权益分派实施公告

公司8月5日发布公告，上海雅创电子集团股份有限公司2024年年度权益分派方案为：以截至2025年4月18日公司现有总股本114,158,291扣除以集中竞价交易方式回购3,752,767股股份后的股份总数110,405,524股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量。

德邦科技：持股5%以上股东减持股份计划公告

公司8月5日发布公告，截至本公告披露日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有烟台德邦科技股份有限公司股份22,261,054股，占公司股份总数15.65%。前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于2023年9月19日解除限售并上市流通。国家集成电路基金因自身资金安排，拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过4,267,200股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的1%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的2%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。

永新光学：持股5%以上大股东减持股份计划公告

公司8月6日发布公告，控股股东陈敬全因自身资金需求，计划在2025年8月28日至2026年2月27日期间以集中竞价或大宗交易方式减持不超过214万股股份，占公司总股本比例不超过2%。公告中明确了减持方式、减持期间、价格限制等相关信息，并承诺本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对治理结构与持续经营造成实质性影响。

电连技术：关于收购控股子公司少数股东股权的公告

公司8月6日发布公告，拟以现金1.28亿元收购控股子公司成都电连电子有限公司5%少数股东股权，交易对方为自然人杨某。交易完成后，成都电连将成为公司全资子公司。公告指出，此次交易有助于提高公司整体决策效率和资源整合能力，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

盛美上海：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

公司8月6日发布公告，根据2024年度实施的权益分派事项，将原2023年限制性股票激励计划中未解锁部分的授予价格从72.10元/股调整为70.98元/股。调整依据为《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股东大会授权条款。此次调整不影响激励计划其他条款的有效性。

长光华芯：董事减持股份计划公告

公司8月7日发布公告，公司近日收到董事谭少阳出具的《关于股东减持计划的告知函》，因归还贷款等个人资金需求，计划自公司公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。谭少阳拟减持公司股份数量不超过26,260股，占公司总股本的比例不超过0.0149%。本次拟减持股份数量占其个人本次减持前所持有公司股份数量的股份不超过25%。

源杰科技：半导体科技股份有限公司关于签订日常经营重大订单的公告

公司8月7日发布公告，近日陕西源杰半导体科技股份有限公司签订了一份重要销售订单，订单金额为14,149.74万元人民币（含税），该订单自收到客户采购订单并确认生效之日起生效，履行期限至采购订单义务履行完成。本次交易属于公司日常经营销售行为，若订单顺利实施预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将依据具体订单规定及收入确认原则在相应会计期间确认收

入；尽管订单双方均具备良好履约能力，但在履行期间仍可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险导致订单无法如期或全面履行，公司将密切关注订单执行情况并履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

希荻微：希荻微关于2024年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
公司8月7日发布公告，目前公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2025年5月22日至2026年3月2日，预留授予部分第一个行权期实际可行权期限为2025年8月6日至2026年7月2日；本次限制行权期确定为2025年8月15日至2025年8月29日，在此期间全部激励对象将限制行权；公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

世运电路：世运电路股东减持股份计划公告
公司8月8日发布公告，新豪国际计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过21,617,769股，即不超过公司总股本的3.00%。其中：拟通过集中竞价方式减持不超过7,205,923股公司股份，即不超过公司总股本的1.00%，拟通过大宗交易方式减持不超过14,411,846股公司股份，即不超过公司总股本的2.00%。

聚灿光电：2025年半年度权益分派实施公告
公司8月8日发布公告，以公司现有总股本680,152,346股剔除已回购股份32,831,660股后的647,320,686股为基数，向全体股东每10股转增4.5股。实际转增股份为647,320,686股÷10×4.5股=291,294,308股。

弘景光电：对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的公告
公司8月8日发布公告，广东弘景光电科技股份有限公司拟对外投资建设弘景光电研发制造总部基地项目，项目总投资额预计为人民币15.33亿元，其中固定资产投资额预计为人民币7.5亿元。同时，公司拟在中山市取得土地使用权，并与中山火炬工业集团有限公司签订《投资协议》。

五、下周投资提示

表 5：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第六届物联网、人工智能与机械自动化国际学术会议	8.13-8.15	杭州市	杭州电子科技大学
2	第五届智能通信与计算国际学术会议	8.15-8.17	南京市	南京邮电大学、海南大学、桂瑞得信息科技有限公司、江苏第二师范学院、三峡大学、庆应义塾大学、东北大学、科学网
3	第六届区块链技术国际会议	8.15-8.17	呼和浩特市	内蒙古工业大学

公司会议			
序号	公司名称	会议名称	会议时间
1	顺络电子	股东大会召开	2025-08-15
2	胜宏科技	股东大会召开	2025-08-15
3	光智科技	股东大会召开	2025-08-15
4	沪硅产业	股东大会召开	2025-08-15
5	峰岬科技	股东大会召开	2025-08-15
6	欧菲光	股东大会召开	2025-08-14
7	满坤科技	股东大会召开	2025-08-14
8	龙旗科技	股东大会召开	2025-08-14
9	艾为电子	股东大会召开	2025-08-14
10	戈碧迦	股东大会召开	2025-08-14
11	豪声电子	股东大会召开	2025-08-14
12	大港股份	股东大会召开	2025-08-13
13	西陇科学	股东大会召开	2025-08-13
14	木林森	股东大会召开	2025-08-13
15	景旺电子	股东大会召开	2025-08-13
16	瑞联新材	股东大会召开	2025-08-13
17	深天马 A	股东大会召开	2025-08-12
18	洲明科技	股东大会召开	2025-08-12
19	威尔高	股东大会召开	2025-08-12
20	英集芯	股东大会召开	2025-08-12
21	宏微科技	股东大会召开	2025-08-12
22	盈方微	股东大会召开	2025-08-11
23	通富微电	股东大会召开	2025-08-11
24	金百泽	股东大会召开	2025-08-11
25	隆扬电子	股东大会召开	2025-08-11
26	杰华特	股东大会召开	2025-08-11
27	恒烁股份	股东大会召开	2025-08-11
28	兴福电子	股东大会召开	2025-08-11

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 6: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
605099.SH	共创草坪	2025-08-11	43.38	40,164.20	40,052.38	99.72	40,009.00	99.61	股权激励限售股份
688205.SH	德科立	2025-08-11	6,894.94	15,828.53	15,828.53	100.00	8,933.59	56.44	首发原股东限售股份
688002.SH	睿创微纳	2025-08-11	327.50	46,023.75	46,023.75	100.00	45,696.25	99.29	股权激励一般股份
688225.SH	亚信安全	2025-08-11	19,090.22	40,001.00	40,001.00	100.00	20,910.78	52.28	追加承诺限售股

份上市流通									
600328.SH	中盐化工	2025-08-11	92.06	146,630.95	146,630.95	100.00	146,538.90	99.94	股权激励限售股份
600980.SH	北矿科技	2025-08-11	1,211.76	18,926.35	18,779.48	99.22	17,567.72	92.82	定向增发机构配售股份
301206.SZ	三元生物	2025-08-11	9,294.60	20,232.57	13,028.31	64.39	10,761.12	53.19	追加承诺限售股份上市流通
603115.SH	海星股份	2025-08-11	269.04	23,920.00	24,189.04	101.12	23,920.00	100.00	股权激励期权行权
301318.SZ	维海德	2025-08-11	1,755.00	13,513.09	7,606.37	56.29	5,851.37	43.30	首发原股东限售股份
301132.SZ	满坤科技	2025-08-11	10,201.40	14,808.62	14,803.72	99.97	4,602.32	31.08	首发原股东限售股份
301536.SZ	星宸科技	2025-08-11	65.52	42,106.00	18,724.36	44.47	18,658.84	44.31	股权激励一般股份
603055.SH	台华新材	2025-08-11	142.89	89,029.26	88,688.15	99.62	88,545.26	99.46	股权激励限售股份
601865.SH	福莱特	2025-08-11	86.00	234,292.01	190,106.51	81.14	190,020.51	81.10	股权激励限售股份
000657.SZ	中钨高新	2025-08-11	804.78	227,895.44	125,502.71	55.07	124,697.94	54.72	股权激励限售股份
301186.SZ	超达装备	2025-08-11	42.20	7,994.82	7,515.99	94.01	7,473.79	93.48	股权激励一般股份
688671.SH	碧兴物联	2025-08-11	98.15	7,851.89	4,684.71	59.66	4,586.56	58.41	首发战略配售股份
300508.SZ	维宏股份	2025-08-11	83.63	10,792.50	8,190.84	75.89	8,107.21	75.12	股权激励一般股份
603040.SH	新坐标	2025-08-12	72.73	13,648.69	13,579.06	99.49	13,506.34	98.96	股权激励限售股份
688008.SH	澜起科技	2025-08-12	36.21	114,515.13	114,515.13	100.00	114,478.93	99.97	股权激励一般股份
688041.SH	海光信息	2025-08-12	143,778.09	232,433.81	232,433.81	100.00	88,655.72	38.14	首发原股东限售股份
301336.SZ	趣睡科技	2025-08-12	1,425.34	4,000.00	3,043.03	76.08	2,574.66	64.37	首发原股东限售股份
002326.SZ	永太科技	2025-08-12	445.48	92,540.08	80,849.84	87.37	80,404.36	86.89	股权激励限售股份
301310.SZ	鑫宏业	2025-08-12	61.64	13,593.80	5,024.42	36.96	4,962.78	36.51	股权激励一般股份
300051.SZ	璩升科技	2025-08-12	204.36	37,213.67	36,773.10	98.82	36,568.74	98.27	股权激励限售股份
002869.SZ	金溢科技	2025-08-12	151.20	17,955.63	15,951.16	88.84	15,951.16	88.84	股权激励限售股份

688435.SH	英方软件	2025-08-13	103.47	8,350.00	4,718.26	56.51	4,614.79	55.27	首发战略配售股份
688017.SH	绿的谐波	2025-08-13	11.74	18,333.01	18,333.01	100.00	18,321.27	99.94	股权激励一般股份
600682.SH	南京新百	2025-08-13	18,073.89	134,613.22	134,579.92	99.98	116,506.03	86.55	追加承诺限售股份上市流通
002514.SZ	宝馨科技	2025-08-14	16,600.00	72,003.43	72,003.43	100.00	55,403.43	76.95	定向增发机构配售股份
603088.SH	宁波精达	2025-08-14	227.88	50,238.80	43,787.18	87.16	43,559.31	86.70	股权激励限售股份
300213.SZ	佳讯飞鸿	2025-08-14	630.25	59,436.47	55,222.19	92.91	54,591.94	91.85	股权激励限售股份
603112.SH	华翔股份	2025-08-14	31.27	53,917.06	50,519.87	93.70	50,488.60	93.64	股权激励限售股份
603310.SH	巍华新材	2025-08-14	11,548.80	34,534.00	18,456.00	53.44	6,907.20	20.00	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
002262.SZ	恩华药业	2025-08-14	257.66	101,578.66	88,422.06	87.05	88,164.40	86.79	股权激励限售股份
002736.SZ	国信证券	2025-08-14	47,358.76	961,242.94	961,242.94	100.00	913,884.18	95.07	定向增发机构配售股份
002306.SZ	*ST 云网	2025-08-15	2,223.00	86,976.25	83,619.04	96.14	81,396.04	93.58	股权激励限售股份
688548.SH	广钢气体	2025-08-15	989.55	131,939.85	69,120.90	52.39	68,131.35	51.64	首发战略配售股份
688283.SH	坤恒顺维	2025-08-15	3,630.84	12,180.00	12,180.00	100.00	8,549.16	70.19	追加承诺限售股份上市流通
001339.SZ	智微智能	2025-08-15	17,600.00	25,170.79	25,085.16	99.66	7,485.16	29.74	首发原股东限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。